

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、_____ 殿 に納入する
2.5 mm ピッチ 電線対基板 コネクタ (1列DIP品) について規定する。

This product specification covers the performance requirements for 2.5 mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR (SINGLE DIP TYPE) series for limited use by _____.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製品型番 Part Number
リセ ターミナル Receptacle Terminal	5 1 5 9 PBT/PBTL
リセ ハウジング Receptacle Housing	5 0 5 1 - * *
プラグ アセンブリ Plug Assembly	5 0 4 5 - * * F

* : 図面参照 Refer to the drawing

REV.	A	B	C					
SHEET	1-15	1-15	1-15					
REVISE ON PC ONLY				TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING				
C	変更 REVISED 122278 2017/09/22			製品仕様書				
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								
REV.	DESCRIPTION							
DESIGN CONTROL J			STATUS	WRITTEN BY: SOBARA	CHECKED BY: AIDA	APPROVED BY: TKANEKO	DATE: 2017/04/20	
DOCUMENT NUMBER 50510000				DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL		SHEET 1 OF 15
EN-127(2015-12)								

【3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES】

項目 Item	規格 Standard		格
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	250 V		[AC (実効値 rms) / DC] 被覆外径 : φ(1.2)~φ1.7mm Insulation O.D.
最大許容電流 及び適用電線 Rated Current (MAX.) and Applicable wires	AWG # 22	3.0 A	
	AWG # 24	2.5 A	
	AWG # 26	2.0 A	
	AWG # 28	1.5 A	
使用温度範囲*1 Ambient temperature Range	- 40 °C ~ + 105 °C*2*3 低温において氷結しないこと Not freeze to low temperature		

- *1 : 基板実装後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。
Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.
- *2 : 通電による温度上昇分を含む。
This includes the terminal temperature rise generated by conducting electricity.
- *3 : 適合電線等も本使用温度範囲を満足すること。
Applicable FPC (wires and cables) must also meet the specified temperature range.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING			製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 15	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
	50510000	PS	000	GENERAL	2 OF 15

【4. 性能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical performance

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、短絡電流 10mA 以下にて測定する。(JIS C5402-2-1) Mate connectors, and measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX. (JIS C5402-2-1)	20 mΩ MAX.
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間 及びターミナル、アース間に、DC 500V を印加し測定する。(JIS C5402-3-1/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors, apply 500V DC between adjacent terminal or ground. (JIS C5402-3-1/MIL-STD-202 Method 302)	1000 MΩ MIN.
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間 及びターミナル、アース間に、AC(rms) 1000V (実効値) を 1分間 印加する。(JIS C5402-4-1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors, apply 1000V AC(rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground. (JIS C5402-4-1/MIL-STD-202 Method 301)	製品機能を損なう 異常なきこと No Damage on function
4-1-4	圧着部接触抵抗 Contact Resistance on Crimped Portion	ターミナルに適合電線を圧着し、開放電圧20mV以下、短絡電流 10mA 以下にて測定する。 Crimp the applicable wire to the terminal, measured by dry circuit, 20mV MAX., 10mA.MAX.	5 mΩ MAX.

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 15

TITLE:

Mini-Latch 2.5
FLANGE PIN TYPE TIN PLATING

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
50510000

DOC. TYPE
PS

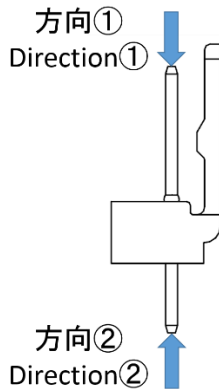
DOC. PART
000

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
3 OF 15

4 - 2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition		規格 Requirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分25±3mmの速さで挿入、抜去を行う。 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 25±3mm/minute.		第6項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	圧着部引張強度 Crimping Pull out Force	圧着されたターミナルを治具に固定し、電線を軸方向に毎分25±3mmの速さで引張る。 (JIS C5402-16-4) Fix the crimped terminal to the jig, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 25±3 mm/minute. (JIS C5402-16-4)	AWG#22	39.2 N{4.0 kgf}MIN.
			AWG#24	29.4 N{3.0 kgf}MIN.
			AWG#26	19.6 N{2.0 kgf}MIN.
			AWG#28	9.8 N{1.0 kgf}MIN.
4-2-3	圧着端子挿入力 Crimp Terminal Insertion Force	圧着されたターミナルをハウジングに挿入する。 Insert the crimped terminal into the housing.		14.7 N {1.5 kgf } MAX.
4-2-4	圧着端子保持力 Crimp Terminal Retention Force	ハウジングに装着した圧着されたターミナルを毎分 25±3mm の速さで引張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3 mm/minute on the crimped terminal assembled in the housing.		14.7 N {1.5 kgf} MIN.
4-2-5	HDR端子強度 Header Terminal Strength	ピッチおよびスパン方向に1分間、4.9Nの荷重を加える。 Apply a load of 4.9 N on the terminal in pitch and span direction for 1 minute.		割れ、折れの無きこと No Damage
4-2-6	HDR端子保持力 Header Terminal Retention Force	ハウジングに圧入されたターミナルを毎分 25±3mm の速さで軸方向に押す。 Apply axial push out force at the speed rate of 25±3 mm/minute on the terminal assembled in the housing.	方向① Direction①	19.6 N {2.0 kgf} MIN.
			方向② Direction②	9.8 N {1.0 kgf} MIN.



REVISE ON PC ONLY	
C	SEE SHEET 1 OF 15
REV.	DESCRIPTION

TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING	製品仕様書
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	

DOCUMENT NUMBER 50510000	DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 4 OF 15
-----------------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------

4-3. 環境性能、その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Insertion / Withdrawal	1分間 10回 以下の速さで、挿入、抜去を30回 繰返す。 Insert and withdraw connectors 30 cycles repeatedly by rate of less than 10 cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、全ての圧着端子を直列に接続し最大許容電流で熱平衡に達した時の温度上昇を測定する。(UL498) Mate connectors and all crimp terminals shall be connected in a direct series. The temperature rise shall be measured when the terminal reaches terminal equilibrium allowable current. (UL498)	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAX.
4-3-3	耐振動性 Vibration	コネクタを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向に 掃引割合 10~55~10 Hz/分、全振幅 1.52mm の振動を各2時間 加える。(ケーブルは固定すること) (JIS C 60068-2-6/MIL-STD-202 試験法 201) Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test. (Fix the cable at test.) Amplitude : 1.5mm P-P Frequency : 10~55~10 Hz in 1 minute. Duration : 2 hours in each X.Y.Z.axes. (JIS C 60068-2-6/MIL-STD-202 Method 201)	外観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
			瞬断 Discontinuity	1 μsec. MAX.
4-3-4	耐衝撃性 Mechanical Shock	コネクタを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、テストパルス半周期、嵌合軸を含む互いに垂直な6方向に 490m/s ² {50G}、作用時間11msの衝撃を各3回、合計18回加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) Mate connectors and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA current during the test. (Total of 18 shocks) Test pulse : Half Sine Peak value : 490 m/s ² (50 G) Duration : 11 ms (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	外観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
			瞬断 Discontinuity	1 μsec. MAX.

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 15

TITLE:
Mini-Latch 2.5
FLANGE PIN TYPE TIN PLATING

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
50510000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
000

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
5 OF 15

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、105±2°C の雰囲気中に96時間放置後取り出し、1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) Mate connectors and expose to 105±2°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours , after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	外観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、-40±3°C の雰囲気中に96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。(JIS C60068-2-1) Mate connectors and expose to -40±3°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)	外観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
4-3-7	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、60±2°C、相対湿度90~95% の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-78/MIL-STD-202 試験法 103) Mate connectors and expose to 60±2°C, relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-78/MIL-STD-202 Method 103)	外観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 MΩ MIN.
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 15

TITLE:

Mini-Latch 2.5
FLANGE PIN TYPE TIN PLATING

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
50510000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
000

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
6 OF 15

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、 $-55\pm 3^{\circ}\text{C}$ に 30分、 $+105\pm 2^{\circ}\text{C}$ に 30分。これを1サイクルとし、5サイクル 繰返す。 但し、温度移行時間は 5分以内 とする。 試験後1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-14) Mate connectors and subject to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 5 cycles of : a) $-55\pm 3^{\circ}\text{C}$ 30 minutes b) $+105\pm 2^{\circ}\text{C}$ 30 minutes (JIS C60068-2-14)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
4-3-9	塩 水 噴 霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ にて $5\pm 1\%$ 重量比の塩水を 48 ± 4 時間噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101) Mate connectors and expose to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration : $5\pm 1\%$ Spray time : 48 ± 4 hours Ambient temperature : $35\pm 2^{\circ}\text{C}$ (JIS 60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	外 観 Appearance	製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.

REVISE ON PC ONLY

C

SEE SHEET 1 OF 15

TITLE:

Mini-Latch 2.5
FLANGE PIN TYPE TIN PLATING

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
50510000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
000

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
7 OF 15

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-10	耐亜硫酸ガス SO ₂ Gas	コネクタを嵌合させ、40±2°Cにて50±5ppmの 亜硫酸ガス中に24時間放置する。 Mated connectors and expose to the conditions of 50±5ppm SO ₂ gas ambient temperature 40±2°C for 24 hours.	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異常なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
4-3-11	耐アンモニア性 NH ₃ Gas	コネクタを嵌合させ、濃度28%のアンモニア 水を入れた容器中に40分間放置する。 (1Lに対して25mLの割合) Mated connectors and expose to the conditions of NH ₃ gas evaporating from 28% NH ₃ solution for 40 minutes. (Rate is 25ml per 1L)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異常なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING			製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 15	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION	DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 8 OF 15
DOCUMENT NUMBER 50510000					EN-127(2015-12)

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-12	はんだ付け性 Solderability	ターミナルまたはピンを本体取付け基準面より1.2mm迄、245±3°Cのはんだに3±0.5秒浸す。 Dip terminal or pin into immerse the area up to 1.2mm from the bottom of the housing into solder molten at 245±3°C for 3±0.5 sec.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の95%以上に付着のことが95% of immersed area must be plated.
4-3-13	はんだ耐熱性 Resistance to Soldering Heat	<u>フローディップの場合</u> Flow dip method 第7項の推奨温度条件にてフローを行う。 Using the flow condition below paragraph 7, the product was flowed.	外 観 Appearance	端子ガタ、割れ等製品機能を損なう異常なきこと No Damage on function
		<u>手はんだ時</u> (Reflow by Manual Soldering iron) 350±10°Cのはんだゴテにて最大5秒加熱する。但し、端ピンに異常な加圧のないこと。 Using a soldering iron (350±10°C for 5 seconds MAX.) heat up. However, do not apply excessive pressure to either the terminals.		

(): 参考規格 Reference Standard
{ }: 参考単位 Reference Unit

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

5-1. 製品寸法及び材質 Dimensions and materials of product.

図面参照 Refer to the drawing.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING			製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 15	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
	50510000	PS	000	GENERAL	9 OF 15

【6. 挿入力及び抜去力 INSERTION / WITHDRAWAL FORCE】

極数 No. of CKT	単位 UNIT	挿入力 (最大値) Insertion (MAX.)			抜去力 (最小値) Withdrawal (MIN.)		
		初回 1st	6回目 6th	30回目 30th	初回 1st	6回目 6th	30回目 30th
2	N {kgf}	35.3 {3.6}	33.4 {3.4}	33.4 {3.4}	6.40 {0.65}	5.40 {0.65}	5.40 {0.65}
3	N {kgf}	43.2 {4.4}	40.2 {4.1}	40.2 {4.1}	6.87 {0.70}	5.89 {0.60}	5.89 {0.60}
4	N {kgf}	51.0 {5.2}	47.1 {4.8}	47.1 {4.8}	7.36 {0.75}	6.38 {0.65}	6.38 {0.65}

※ { } :参考単位 Reference Unit

【7. フロー条件 FLOW CONDITION】

項目	温度	時間
はんだ槽 Solder bath	250±5°C	5±0.5sec.
予備加熱 Pre-heat	100~120°C	60sec.

フロー温度条件
TEMPERATURE CONDITION

(はんだ接合部の基板表面にて測定)

(Temperature is measured at the soldering area on the surface of PWB)

注記：本フロー条件に関しては、フロー装置及び基板などにより条件が異なりますので
事前に実装評価(フロー評価)の御確認を御願ひ致します。
端子テール部が変色する場合がございますが、はんだ付け性には問題ありません。

NOTE : Please check the mount condition (flow soldering condition) by your own devices
beforehand, because the condition changes by the soldering devices, printed wiring boards (PWB),
and so on. Although tail of terminal may discolors, a solderability does not have a problem.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING			製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 15	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION	DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 10 OF 15
DOCUMENT NUMBER 50510000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 10 OF 15

【8. 圧着端子取り扱い上の注意事項 INSTRUCTION UPON USAGE OF CRIMP TERMINAL】

1. 保管する場合には、外装カートン表示に従って保管願います。縦置き又は、天地逆にて保管すると巻き緩みの原因になります。
When storing crimp terminal, please follow the view of outer carton. Do not store in an upright position or upside down. It could loosen the terminal.

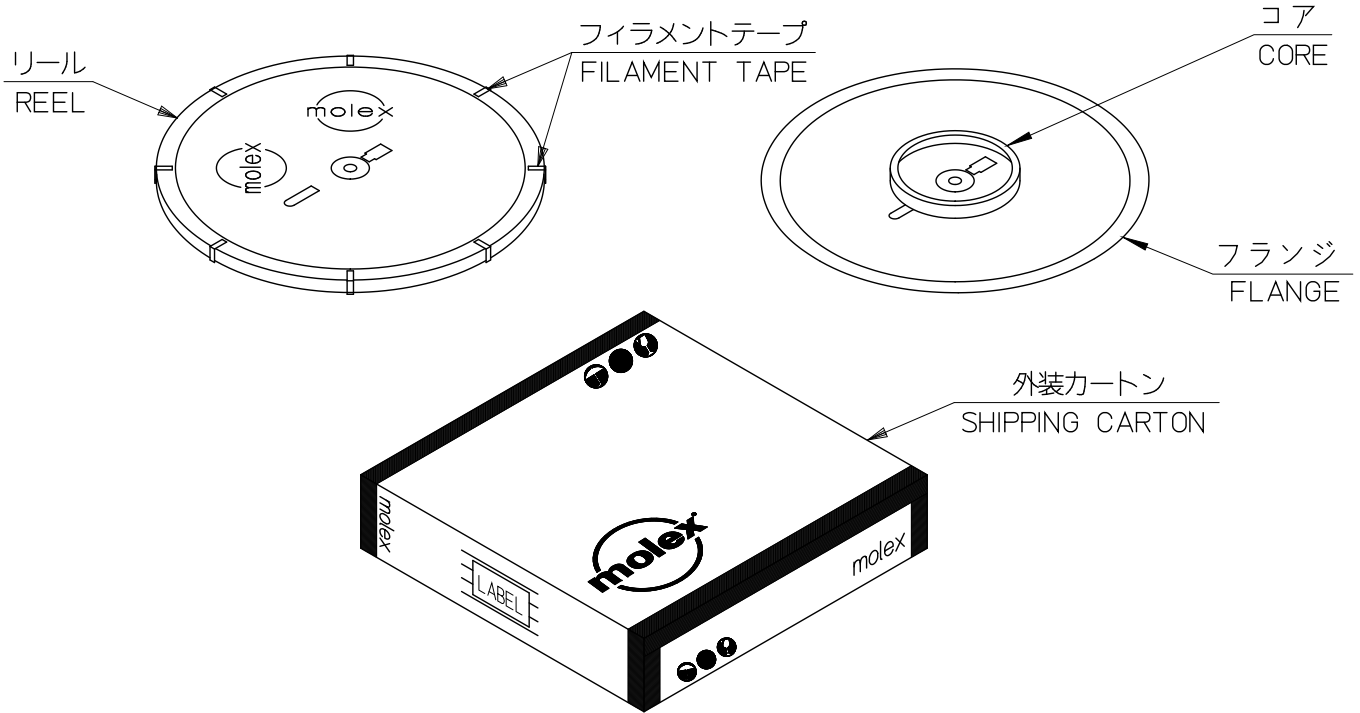


図1 端子梱包に関する各部名称
FIG.1. NOMENCLATURE FOR THE TERMINAL PACKAGING

2. 保管環境に著しい高温・湿度がある場合、端子表面層に錆等の影響を及ぼす事がありますのでご注意願います。
When storing the terminal in the significant temperature or, humidity, may be affected at the terminal surface.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING		
C	SEE SHEET 1 OF 15	製品仕様書		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 50510000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL
				SHEET 11 OF 15

3. 輸送、運搬時、カートン内リール数が規定梱包数量に満たない場合には、リールに衝撃を与えぬ様に緩衝材を入れガタつき防止を行って下さい。
When number of reel in carton less than the prescribed quantity, prevent looseness with adding the cushion, during transport, conveyance.

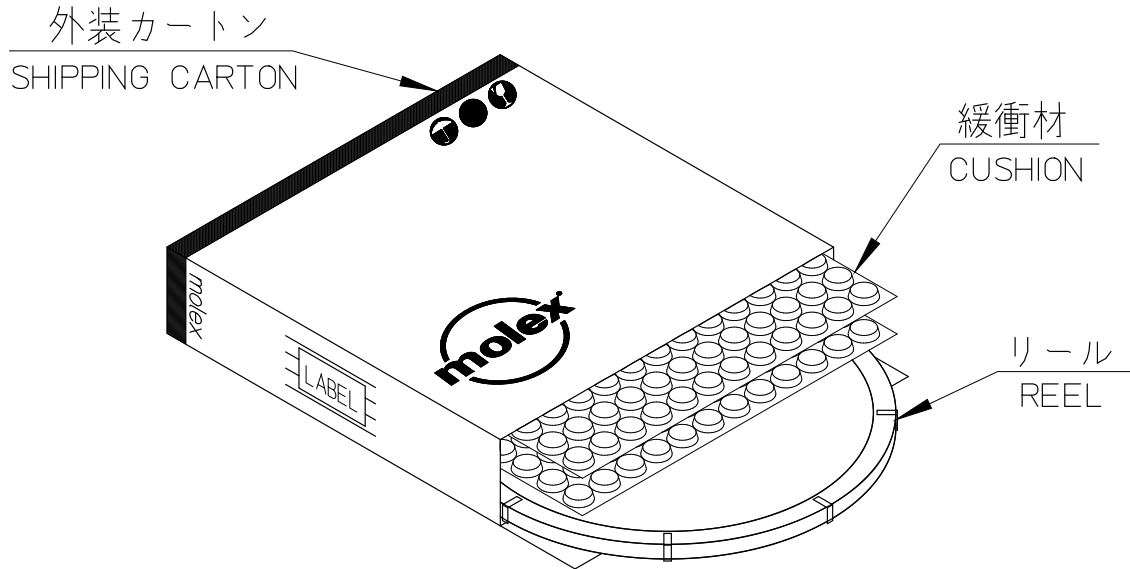


図2 カートン内リール数が規定梱包数量に満たない場合の梱包方法
FIG.2 PACKAGING METHOD, IN CASE OF NUMBER OF REEL
IN CARTON LESS THAN THE PRESCRIBED QUANTITY

REVISE ON PC ONLY		TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING		
C	SEE SHEET 1 OF 15	製品仕様書		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 50510000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL
				SHEET 12 OF 15
EN-127(2015-12)				

4. カートンからリールを取り出す際は、両側フランジを持ち取り出して下さい。片面だけを掴んだ場合端子自重によりコア部からフランジ面が剥がれる恐れがあります。
When removing the reel from the carton, please remove with holding the flange on both sides. Do not grab only one side. It could detach the flange from the core.

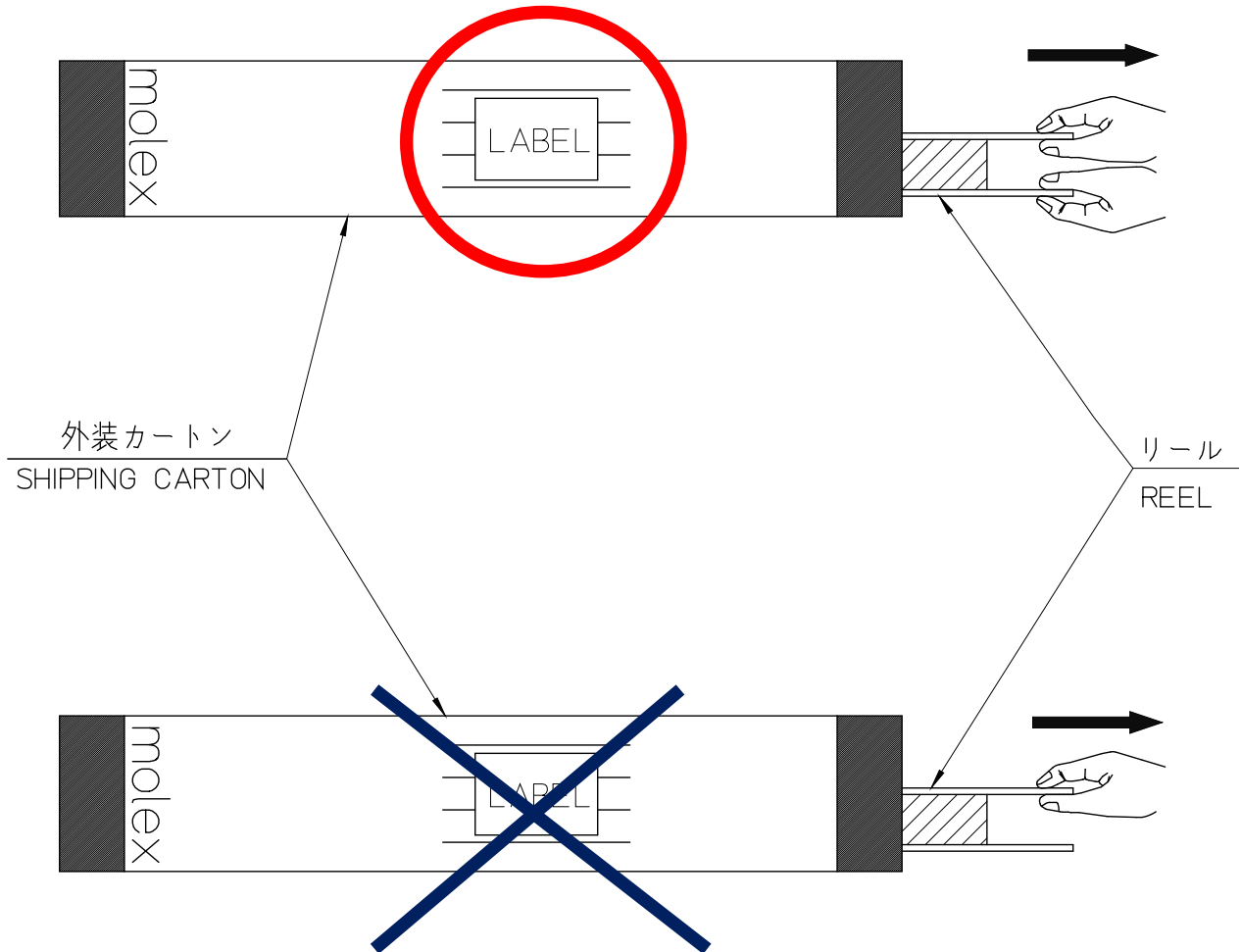
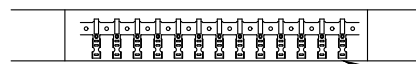
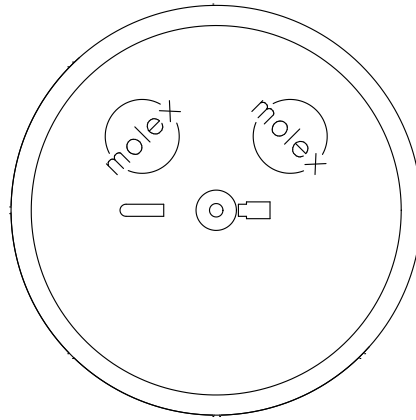


図3 リールの取り出し方法
FIG.3 METHOD OF REMOVING THE REEL FROM THE CARTON

REVISE ON PC ONLY		TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING		
C	SEE SHEET 1 OF 15	製品仕様書		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 50510000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL
				SHEET 13 OF 15

5. 本製品はセンターキャリア品の為、カートンよりリールを取り出し保管される場合には、バレル側を下側にして保管願います。
バレル側を上にして保管されますと端子自重により巻き緩みが発生する恐れがあります。
When storing the terminal with remove the reel from the carton, please keep barrel down side.
Because this item has center career. Do not keep barrel up side. It could loosen the terminal.



バレル側を下
BARREL SIDE ORIENTED DOWNWARD

図4リール保管時の向き
FIG.4 DIRECTION OF THE REEL STORAGE

6. 圧着機へリールを長時間掛けた状態でいますと、端子自重により巻き緩みが発生する恐れがあります。
ご使用にならない場合には、中間紙で端子全周を2~3周巻いた後、巻き緩みが生じない様、中間紙先端、フランジ間のテープ止めをし、バレル側を下にして保管願います。
Do not put the reel in the crimping machine for long period. It could loosen the terminal. When it is not used, after rolling interleaf twice, or three times into terminal all around, please keep barrel down side, with taping tip of the interleaf and flange.
7. 圧着仕様を満足する為に、当社推奨圧着機のご使用をお願い致します。
In order to meet the crimp specification, please use our recommended crimping machine.
8. 外装カートン組立及び、中間紙繋ぎにステープル(ホチキス)は、使用しないで下さい。
Stapler prohibited in whole area with outer carton assembly, linking the interleaf .

REVISE ON PC ONLY		TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING			
C	SEE SHEET 1 OF 15	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
	REV.				DESCRIPTION
DOCUMENT NUMBER 50510000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 14 OF 15
製品仕様書					
EN-127(2015-12)					

molex PRODUCT SPECIFICATION

LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY :
A	RELEASED	'17/05/24	116805	SOBARA01	AIDA
B	REVISED	'17/08/14	120307	SOBARA01	AIDA
C	REVISED	'17/09/22	122278	SOBARA01	AIDA

REVISE ON PC ONLY		TITLE: Mini-Latch 2.5 FLANGE PIN TYPE TIN PLATING	製品仕様書
C	SEE SHEET 1 OF 15		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	

DOCUMENT NUMBER 50510000	DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 15 OF 15
------------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------